

Datenblatt Produkt FK 273 MI 247 H



Board Level Kühlkörper>Aufsteckkühlkörper

- universelle Aufsteckkühlkörper für die Bauform TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche
- integrierte Klammergeometrie zur sicheren Fixierung des Bauteils
- gewinkelte Ausführungen mit vergrößerter Oberfläche
- Modifikationen und Sonderausführungen nach Kundenvorgabe

Kenndaten

Material:	Kupfer (Cu)
für Transistor:	<ul style="list-style-type: none"> • TO 220 • TO 248 • SIP-Multiwatt • TO 247 • TO 218
Breite:	23 mm
Höhe:	9 mm
Länge:	36 mm
Wärmewiderstand:	19,6 K/W
Oberfläche:	lötfähige Oberfläche
Ausführung:	mit Lötflanke für horizontalen Einbau
Materialstärke:	0,6 mm

Technische Zeichnung

